

JPCA Show 2009/2009 マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2009 第3回先進エレクトロニクスパビリオン」出展要項



JPCA Show 2009/2009 マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2009 出展者の皆様へ第3回先進エレクトロニクスパビリオン出展要項についてご案内申し上げます。第3回先進エレクトロニクスパビリオンでは、出展者の皆様が下記先進エレクトロニクスに係わる製品・技術 PR のためのパネル展示・製品展示を無料で行って頂けるコーナーを設置しております。また、パビリオン会場に隣接しているオープンセミナ会場での“先進エレクトロニクスパビリオンセミナ”へも無料でご参加いただけます。是非、この機会を有効にご利用頂きたく下記要項をご覧の上、別添のお申込書を期日までにご返送下さいますようお願い申し上げます。

記

1.開催・募集内容

①パネル展示・製品展示について

- 会 期:2009年6月3日(水)~6月5日(金)
- 会 場:東京ビッグサイト 東展示棟4ホール 第3回先進エレクトロニクスパビリオンコーナー(予定)

●展示対象:【モバイル・ディスプレイ・カーエレクトロニクスゾーン】

モバイル情報家電用電子回路製品、水晶振動子、SAWフィルタ、制御チップ、チューナモジュール、カメラモジュール、高性能二次電池、フラットパネルディスプレイ用電子回路製品、各種ディスプレイ製造装置(スプレタリング、CVD、コート&デポジット、露光、洗浄、ドライエッチング・アッシング、イン注入、エキシマレーザアニール、配向膜塗布、ラミネーション・UV配向、スパッタ散佈、貼り合わせ、液晶注入、スクライバ/ブレード、ペーカ、OLB等)及び試験・検査装置、PDP製造用各種部材、LCD製造用各種部材、有機ELD製造用各種部材、FED/SED製造用各種部材、カーエレクトロニクス用電子回路製品、車載デバイス、車載モジュール、車載制御システム、モバイル/ディスプレイ/カーエレクトロニクス設計・製造・検査システム、電子材料、副資材など。

【部品内蔵・3次元PKGゾーン】

部品内蔵・3次元パッケージング技術を可能とする材料、設計、製造、検査プロセスに関する要素技術全般。例えば、配置CADツール(全体配置・構造、部品構造解析、電極・配線構造解析、凹部・貫通孔部への部品配置、面内・垂直構造特定等)、膜形成材料・装置(焼成、めっき、薄膜成長、塗布、その他)パターン形成材料・装置(フォトリソ、転写、印刷、エッチング、剥離、その他)、後処理材料・装置(トリミング、プレス、加圧、平坦化処理、熱処理、乾燥、表面処理)、特定プロセス材料・装置(加工・形成、ペースト、フィラ、樹脂封入・封止・埋め込み、凹部保護、位置決め、その他)、IC、薄型チップ部品、LTCC、部品内蔵用電子回路基板、内層回路部品実装・ボンディング/マウンティング装置、検査装置など。

【サーマルマネージメントゾーン】

熱対策製品・システム(熱制御装置、浸漬冷却システム、ラジエータ、極限熱制御システム、温度コントローラ、温度センサ、サーモグラフィ、電源調節器、湿度コントローラ、ヒートシンク、強制冷却システム、排熱利用機器・システム、盤用熱交換器・システム等)、熱対策部品(放熱フィン、ヒートパイプ、熱輸送デバイス、ヒートスプレッドャ、ペルチェ素子・モジュール、GPUクーラ、ファンモータ、マイクロクーラ、マイクロポンプ、温度ヒューズ等)、熱対策材料・素材(高熱伝導アルミ基板・金属基板、放熱シート、高熱伝導性接着剤、シリコンゴム、絶縁材料、放熱電子回路基板、冷媒アロイ・コンパウンド、放熱材、熱対策用コーティング材、放熱ケリクス等)、熱対策(熱伝導解析・熱流体解析)技術ソフトウェアなど。

●出展料： 無料（JPCA Show 2009/2009 マイクロエレクトロニクスショー/JISSO PROTEC 2009
出展者は無料でご出展いただけます。）

●運営事務局でご用意する物：①～③のいずれか1つをご選択下さい。

①パネル掲示用ボード(1枚用)+ガラスケース1台

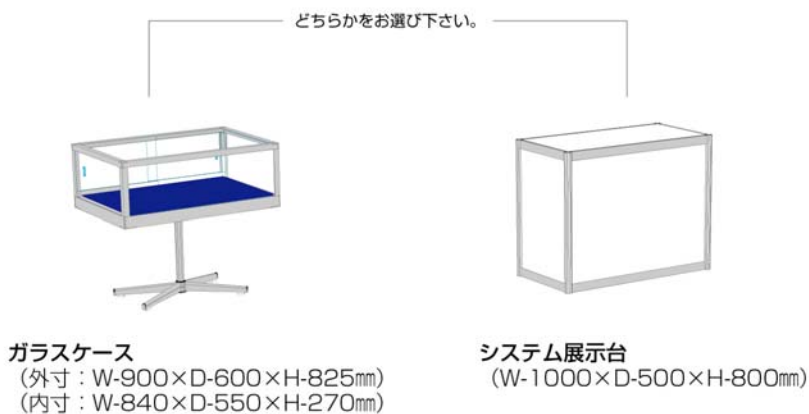
②パネル掲示用ボード(1枚用)+展示台

③装置等設置スペース(1小間分 3m×3mまで無料)

注意：展示するパネル製作は各社でご用意下さい。(A1サイズ)

※上記の他に追加でパネル展示用ボード、ガラスケース、展示台、装置スペースをご希望の場合は、有料となります。

・ パネル展示用ボード	5,460円(税込)
・ ガラスケース	14,700円(税込)
・ 展示台	8,925円(税込)
・ 装置等設置スペース	126,000円(税込)
・ パネル製作をご依頼の場合	29,400円(税込)／枚



●搬入・搬出について 展示パネルの搬入につきましては、6月2日(火)搬入最終日までに先進エレクトロニクスパビリオン内で、ご社名を表示してありますパネル展示用ボードの前に搬入してください。パネルの貼り付けは運営事務局で行います。

また、搬出は6月5日の16:00～となります。17:00以降になってパネル、製品が置いてある場合は、事務局で処分をさせていただきますので、予めご了承下さいませようお願いいたします。

※装置の搬入・出方法については、後日お申込者にご連絡をさせていただきます。

②先進エレクトロニクス PR セミナ

上記出展の他に、先進エレクトロニクスパビリオン内オープンセミナ会場にて出展者による先進エレクトロニクス PR セミナを開催します。こちらへの参加も無料ですので、是非この機会をお見逃しなく、沢山のご応募をお待ちしております。

●講演発表方法

- ① 講演発表当日は、プログラムに従って順次ご発表頂きます。
- ② 発表時間は、当日配布資料、アンケート配布・回収、発表用 PC/プロジェクタへの設置・接続、その他講演機材準備・設置・撤去や質疑応答も含め 1 講演 45 分間です。講演時間(発表コアタイム)以外は、自社出展ブース等発表会場以外でのご対応をお願い致します。
- ③ 事務局側で準備する会場内発表用備品使用に関しては、補助スタッフにお問い合わせ下さい。

2. 申込締切日

平成21年2月13日(金) 厳守

3. 本件についてのお申込・お問合せ先

社団法人日本電子回路工業会

担当: 渡部、岡田、松平

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館2F

TEL:03-5310-2020 FAX:03-5310-2021 e-mail: show@jpca.org

以上